

Lundi 8	Mardi 9 juin		Mercredi 10 juin		Jeudi 11 juin		Vendredi 12 juin	
	8:30 – 10:00		8:30 – 10:00		8:30 – 10:00		9:00 – 11 :00	
	8:30 – 9:00 Ouverture et présentation de l'atelier 9:00- 10:00 Keynote		Session 2 Apport de l'intelligence artificielle dans l'analyse de défaillance	MA 1 Contrôle non destructif	Tutoriel 5 Technologie et analyse de défaillance des relais	MA 5 Packaging, PCB et assemblages	Tutoriel 7 Tests électriques pour l'analyse de défaillance	MA 7 Contrefaçon ou défaut de fabrication ?
11h	10:15 – 12:15		10:30 – 12:00		10:30 – 12:00			
Ouverture de l'accueil	Tutoriel 3 Microscopie électronique/ionique FIB	Session 1 Packaging, PCB et Assemblages	Session 2 Apport de l'intelligence artificielle dans l'analyse de défaillance	MA 2 Connectique	Session 5 Défiabilisation des composants dans le process industriel ou en utilisation	MA 5 Packaging, PCB et assemblages	11:15– 11:45	
							Bilan de l'atelier	
12h00/14h00 Déjeuner	Déjeuner		Déjeuner		Déjeuner		Déjeuner	
14h00-16h00	14:00 – 16:00		14:00 – 16:00		14:00 – 16:00		14:00	
Tutoriel 1 Techniques d'analyses non destructives : X ray Tomographie X	Tutoriel 4 Analyse de surface	Session 1 Packaging, PCB et Assemblages	MA 3 Fonctionnement d'un labo d'analyse : les pièges à éviter	Session « Analyse de défaillance des composants passifs	Tutoriel 6 Procédés d'assemblage	Session 5 Défiabilisation des composants dans le process industriel ou en utilisation	Départ	
16:30 – 18:00	16:30 – 18:00		16:30 – 18:00		16:30 – 18:00			
Tutoriel 2 Techniques électroniques pour la localisation de défauts	Open questions	Session 1 Packaging , PCB et Assemblages	Session 4 Analyse de défaillance des circuits intégrés VLSI	MA 4 Impact normes et législations sur l'analyse de défaillance	Open questions	MA 6 Nouveaux composants, nouveaux défis.	<div>ATELIER 2026</div> <div>19^{ème} atelier</div> <div>ANADEF</div>	

ATELIER 2026
19^{ème} atelier
ANADEF